



## 海归创业风和雨（二）

○ 陈大同

2001年初创时，展讯通信公司5位创始人的分工是武平任CEO，我任CTO，张翔任中国总经理（2004年辞职），范仁勇和冀晋分别任副总裁。当时，展讯面对的都是美欧超级大鳄：德州仪器（TI）、摩托罗拉（Motorola）、西门子（Siemens）、飞利浦（Philips）等。手机核心芯片是最复杂的集成电路之一，不仅要求数千万门的超高集成度，还需要超低功耗，以满足长待机时间。更难的是，为了保持不间断的稳定通话，软件算法要处理各种千变万化复杂条件下的小区间实时切换，其超高的开发难度及超大的测试工作量可想而知！在国际大公司中，开发新一代的手机芯片，通常需要500~1000名硬、软件工程师相互配合，工作5~7年，花费至少5亿美元，产品才能成熟上市。而展讯第一期融资只有600万美元，面临着严峻的挑战！

那时，国内有半导体设计经验的人很少，高端人才更是几乎没有。于是，我们在硅谷建了一个十多人的集成电路设计团队（几年后又移回了国内），同时在上海招了五六十个工程师，组成了软件团队。清华无线电系校友卢斌、谢飞、康一和赵彤等先后回国，手把手的传、帮、带，几年内国内员工水平突飞猛进，承担了几乎所有软件开发工作。

硅谷是世界创新中心，它不仅有全球领先的技术，更重要的是它几十年来探索出的创新体系，包括投融资环境、企业家精神及公司管理体系等。当把硅谷经验融合到国内后，展讯公司创造了业界的一个奇迹：6个月完成2.5G手机芯片设计；10个月芯片验证完成；12个月软件集成初步完成，打通电话；又经过一年的测试及通过各种认证，24个月芯

片开始量产！

这其中的酸甜苦辣难以尽诉，仅举数例：

2002年，展讯需第二轮融资时，恰逢互联网泡沫破灭、“9.11”恐怖袭击，硅谷一片萧条，融资难上加难，公司眼看钱快烧完了。危急关头，在武平提议下，高管及美国员工大幅度降薪，助公司度过了难关。而这时能融到钱，展讯的快速研发及大胆创新起到了决定性作用：我们创造性地把三颗芯片（数字、模拟及电源管理）合而为一，而这颗单芯片的面积只为竞争对手一颗数字芯片的三分之一！

2003年，我们有了芯片产品，但卖给谁呢？诺基亚、爱立信、摩托罗拉等国际大品牌，想都别想！国内客户胆子大，敢于试新、当“白老鼠”，可惜没有研发能力。于是，展讯大包大揽，从芯片到软件，到印刷电路板和机壳设计，到认证测试，全做了。客户只改个手机外观，再换个开机画面，产品就完成了，不折不扣的“整体解决方案”！于是，在深圳催生了无数贴牌手机生产商，形成了日后著名的“山寨”手机现象！算起来，俺们与台湾联发科一起，也算是“山寨模式”的共同创始人。

从纯技术公司到市场导向的公司要经过脱胎换骨的痛苦磨练。山寨手机起自MP3音乐功能。俺们想既然是音乐手机，那音质一定要出色，必须是双声道128kps。当时展讯芯片是软件MP3，只能支持单声道64kps。于是，俺们快马加鞭，赶紧设计新芯片。可没想到，俺们刚干到一半，突然市场上铺天盖地冒出无数款MP3手机，都用联发科的芯片，都是单声道32kps！俺们把肠子都悔青了。痛定思

痛，到流行MP4视频手机时，俺们学乖了，搞了一个“准MP4”（实际是动态JPEG技术），赶上了市场窗口。

就这样，凭借高性价比、整体解决方案、灵活的本地支持、“快鱼吃慢鱼”，联发科和展讯在国内市场上激烈竞争，高速发展，短短三四年就把TI、ADI、飞思卡尔（MOTO）等大公司挤出了中国市场。业界对此有个形象的比喻：两个武功高手在帐篷里比武，打了个天昏地暗，不分胜负。出门一看，外面倒下了一片人，都是被俩高手发出的内功误伤的。

从2003年到2007年，展讯的年销售额每年增长2~3倍，达到近10亿元，并在美国NASDAQ成功上市。其后数年，又经历了生生死死，浴血重生。2011年，员工达到1400人，销售额突破40亿元，成为国内第一大独立半导体设计公司。

2000年前后，全球有十几家初创公司开发3G手机芯片，但只有展讯存活下来，为什么呢？并不是俺们特别聪明，只是俺们有两点与众不同：其一，武平建议“挂羊头卖狗肉”：找钱时说要去做3G，拿到钱后，先做2.5G现有的市场。当初业内预测3G市场2002年到2003年起飞，但实际是2005年后，3G才开始流行，绝大多数公司没有等到那一天！其二，俺们有幸回到中国，发现了“山寨”市场，走上了“农村包围城市”的井冈山之道。生逢其时，又见证并参与了中国的大发展，何其幸哉！

## 读者反馈表

亲爱的读者朋友，您好！

感谢您抽出宝贵时间阅读《水木清华》杂志。希望您协助我们完成以下的问卷调查，提出您的宝贵意见和建议。我们将不断改进，为您提供更加丰富、精彩的内容。谢谢！

1. 您阅读了总第27期《水木清华》杂志的多少内容

几乎全部 大部分 一半 一少半 很少一部分

2. 您对《水木清华》的总体印象

非常喜欢 喜欢 一般 不喜欢

3. 您对本刊设计及印刷的整体印象

很好 好 一般 不喜欢

4. 您对本刊各栏目文章的满意度

动态	<input type="checkbox"/> 非常喜欢	<input type="checkbox"/> 喜欢	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不喜欢
封面人物	<input type="checkbox"/> 非常喜欢	<input type="checkbox"/> 喜欢	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不喜欢
专题	<input type="checkbox"/> 非常喜欢	<input type="checkbox"/> 喜欢	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不喜欢
观点	<input type="checkbox"/> 非常喜欢	<input type="checkbox"/> 喜欢	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不喜欢
招生	<input type="checkbox"/> 非常喜欢	<input type="checkbox"/> 喜欢	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不喜欢
大师	<input type="checkbox"/> 非常喜欢	<input type="checkbox"/> 喜欢	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不喜欢
文化	<input type="checkbox"/> 非常喜欢	<input type="checkbox"/> 喜欢	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不喜欢
专栏	<input type="checkbox"/> 非常喜欢	<input type="checkbox"/> 喜欢	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 不喜欢

5. 本期您最喜欢的栏目/文章是：\_\_\_\_\_

6. 您在杂志内容、设计、印刷等方面的其他意见或建议：

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

姓名\_\_\_\_\_入学年份\_\_\_\_\_系别\_\_\_\_\_

工作单位\_\_\_\_\_职务\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_手机\_\_\_\_\_

E-mail\_\_\_\_\_

通讯地址\_\_\_\_\_邮编\_\_\_\_\_

问卷填好后请寄回编辑部：北京市海淀区清华科技园创新大厦A座1210，邮编：100084 或传真至**010-62797336**，或发邮件至**txl@tsinghua.org.cn**参与问卷调查。

## 更正

2012年第7、8期合刊（总第26期）第9页祁锦毅教授的照片应为高上凯教授，特此更正，并向读者致歉，感谢读者关注。